

超微細回路形成

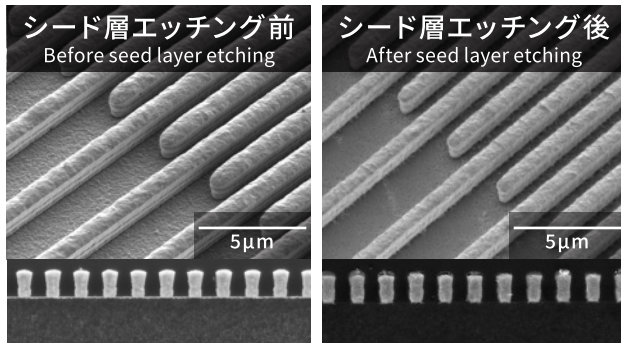
Ultra-fine Pattern Formation

L/S=1/1 μ m達成

can be realized

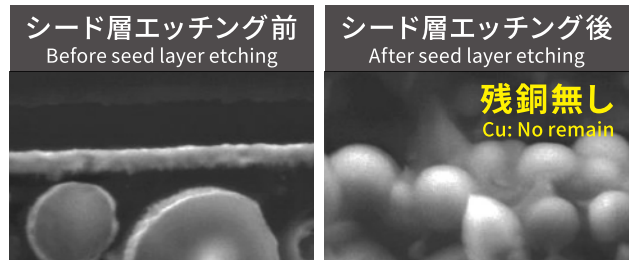
フラッシュエッチング Flash Etching

OPCシードエッチャント OPC SEED ETCHANT



回路細りなし
No damage to fine pattern

アンダーカットなし
No occurrence of undercut

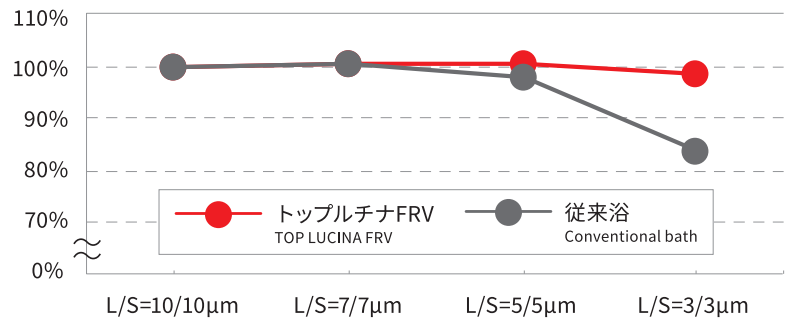
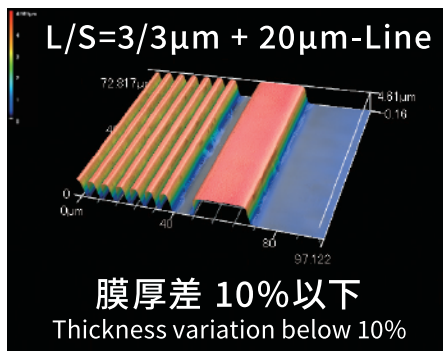


硫酸銅めっき Acid Copper Plating

トッブルチナFRV TOP LUCINA FRV

- めっき膜厚均一性に優れる
Uniform thickness is available

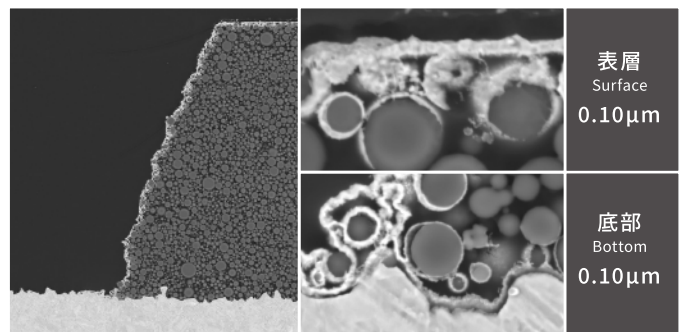
- 微小ブラインドビアホールへのフィリングが可能
Micro-via filling is possible



デスマア・無電解銅めっき De-smear/Electroless Copper Plating

OPC FLETプロセス OPC FLET PROCESS

- 接続信頼性に優れる
Excellent in connecting reliability
- 低膜厚で優れたビア内のめっき析出性が得られる
Realize high via plating performance by thin thickness
- 低粗度材料でも高いピール強度
High peel strength to low Ra material
- 低膜厚でも低いシート抵抗値を示す
Low sheet resistance by thin thickness



絶縁樹脂ABF材

Dielectric layer: ABF substrate

スローイングパワー : 100%

Throwing power